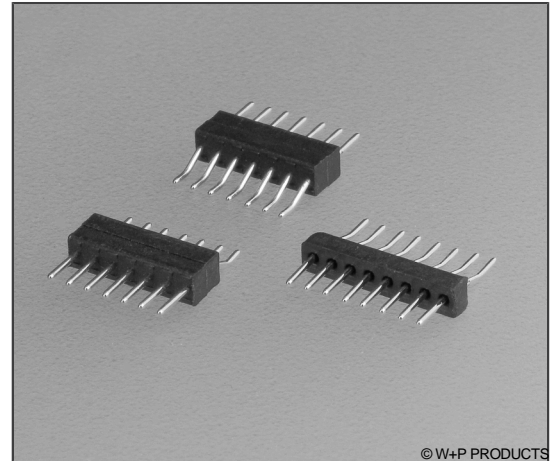


SMT-Präzisions-Stiftleisten RM 1,27mm, liegend, 1-reihig – Rundstifte 0,43mm SMT Precision Pin Headers, 1.27mm Pitch, Horizontal, Single Row – 0.43mm Round Pins

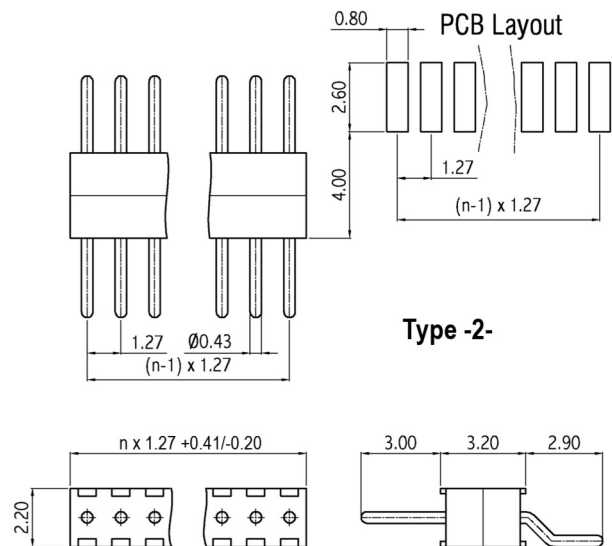
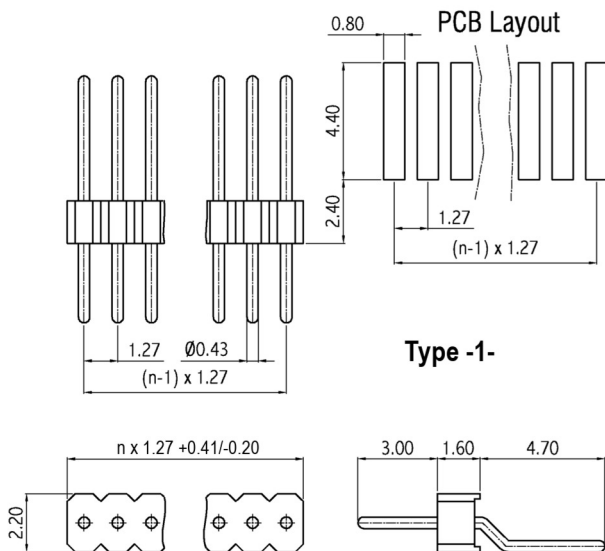
Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Rundkontakt Ø0,43mm, Kupferlegierung <i>Ø0.43mm round contact, copper alloy</i> |
| Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i> | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i> |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i> |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 500 V RMS <i>500 V RMS</i> |
| Nennspannung <i>Voltage Rating</i> | Max. empf. Arbeitsspannung 100 V RMS / 150 V DC <i>Max. rcmd. operating voltage 100 V RMS / 150 V DC</i> |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 1 A <i>1 A</i> |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -55 °C ... +125 °C <i>-55 °C ... +125 °C</i> |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i> |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
1534 1551 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



| | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| Series | Contacts* | Plating* | Type* | Packaging* |
| 7063 | 02 02-50 Einreihig <i>Single row</i> | 10 10 0,25µm Gold <i>0.25µm gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> | 2 1 Iso-Körper 1,60mm <i>Body 1.60mm</i> 2 2x Iso-Körper 1,60 = 3,20mm <i>2x Body 1.60 = 3.20mm</i> | ST ST (Type 1, 2) TR (Option, Type 2) |

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST (Type 1, 2) In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*
TR (Option, Type 2) Tape & Reel (nur Type 2) / *Tape & Reel (Type 2 only)*

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150 °C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200 °C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217 °C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260±5 °C |
| Dauer Höchsttemperatur | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P | max. 8m |

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150 °C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200 °C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217 °C |
| Duration above T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature T_P | 260±5 °C |
| Duration Peak Temperature | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | max. 8min |

